



本社：〒160-8366
東京都新宿区西新宿 6 丁目 24 番 1 号
西新宿三井ビルディング

報告書番号：PCN#20100915000
2010 年 9 月 21 日

お客様各位

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社
営業・技術本部 カスタマドキュメント
マネージャ 牧 達郎 (牧)

HPA(ハイパフォーマンシアナログ) VSP5000PM製品 前処理サイト追加予定のご案内

拝啓 貴社益々ご清栄の事とお喜び申し上げます。平素は弊社製品のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、標題の件につきましてご連絡させていただきます。ご査収の程、宜しくお願い申し上げます。

今回のお知らせは、変更実施についての一次予定の連絡になります。変更の詳細は、次頁以降をご参照下さい。

本通知は、いかなる製品の製造終了に関する状況を変更するものではございません。既に製造終了の連絡をさせていただいている場合には、本通知によって、既通知の最終受注日及び最終出荷日が延長されることはございません。

お客様におかれましては、本通知発行日後、**30** 日以内に通知確認のご連絡をお願いいたします。また、変更前の製品サンプル作製は行わない為、変更品評価用サンプルご入用の場合には、事前に本通知発行日後 30 日以内にご依頼をお願いいたします。変更時期につきましては、次頁以降の変更時期をご参照下さい。お客様の受領連絡及びサンプル依頼は PCN 担当マネージャ或いは担当営業にご連絡下さい。

変更品の出荷につきましては、お客様との早期変更実施の個別契約を締結している場合を除いては、本通知発行日より **90** 日以降に予定いたしております。この通知期間は、弊社品質標準に基づいております。本変更に対するお客様個別のご要求に関しましては、個別契約にて承ります。弊社と合意済みの個別要求につきましては、別途対応させていただきます。担当営業にご確認下さい。

本通知は、通知日前 24 ヶ月以内に本変更対象製品をご購入いただいたお客様に連絡させていただいております。

尚、変更時期につきましては、在庫状況により異なりますので、担当営業にお問い合わせ下さい。また、ご不明な点、ご質問等がございましたら、担当営業或いはpcn_tij@list.ti.comにお問い合わせ下さい。

以上

変更概要

通知タイプ	☒ Initial notice (Plan) ☐ Final notice
変更概要	☐ Design/Specification ☐ Design ☐ Electrical ☐ Mechanical
	☒ Wafer Fab ☒ Site ☐ Process ☐ Material
	☐ Wafer Bump ☐ Site ☐ Process ☐ Material
	☐ Assembly ☐ Site ☐ Process ☐ Material
	☐ Test ☐ Site ☐ Process
	☐ Others ☐ Packing/Shipping/Labeling ☐ -
変更内容	HPA(ハイパフォーマンスアナログ) VSP5000PM製品 前処理サイト追加 現行 : TSMC-WF3社(台湾) 変更後 : TSMC-WF3社(台湾), Vanguard社(台湾)
対象製品	対象製品リスト参照
変更時期	2011 年 1 月上旬の出荷より予定しています。
品質認定試験	☒ 計画 ☐ 終了
製品表示	☐ 変更無し ☒ 変更あり
備考	-

変更内容

内容: 今回のお知らせは、下記変更実施についての一次予定の連絡になります。最終的なお知らせは、弊社内変更審査が終了次第、認定試験の結果を含め、本PCNの更新版の発行をもって連絡させていただきます。

弊社 HPA(ハイパフォーマンスアナログ) VSP5000PM製品の0.35um DPTMプロセス前処理サイトについて、現行 TSMC-WF3社(台湾)サイトにて製造いたしておりますが、供給能力確保の為に、これに加えて、Vanguard社(台湾)サイトでの製造を追加する予定です。尚、今回の変更で、製品についての互換性(寸法/公差), 外観, 動作特性, 品質, 信頼性への影響はありません。

変更内容	現行	変更後
前処理サイト	TSMC-WF3社(台湾)	TSMC-WF3社(台湾) Vanguard 社(台湾)

理由: 供給能力確保の為

対象製品リスト

対象製品名	
VSP5000PM	VSP5000PMG6

製品表示

この変更に伴い、出荷ラベルに記載の前処理サイト記号(ラベルの"20L"の箇所)及び生産国記号(ラベルの"21L"の箇所)及びラベル上の表示位置は、下記の様になる予定です。

	現行	追加認定
Fab Site: 前処理サイト	TSMC-WF3	Vanguard
CS0 (20L): 前処理サイト記号	TS5	VAN
CC0 (21L): 生産国記号	TWN	TWN



図1 出荷ラベルの例

信頼性試験

信頼性試験計画

信頼性試験期間	開始	2010年9月	終了	2010年12月
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qual Device:	VSP5000PM	-	-	
Wafer Fab Site:	Vanguard	Wafer Fab Process:	0.35um DPTM	
MSL:	JEDEC L-1/260C	-	-	
信頼性試験計画				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size		
Electrical Char.	Approved by Product Engineer	Per Spec		
Manufacturability (Wafer Fab)	per mfg. Site specification	Per Spec		